

2023年04月

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

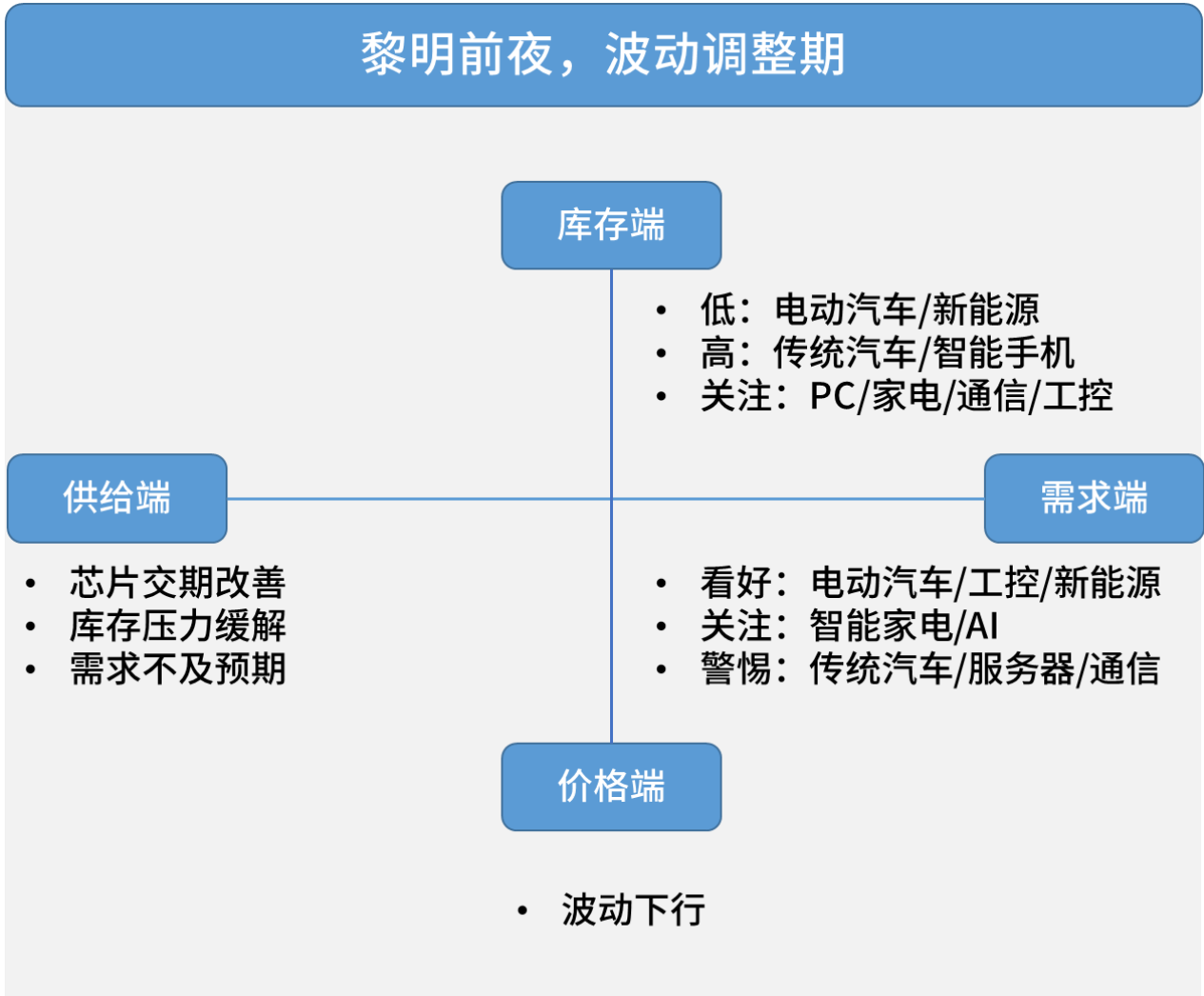
序章.....	2
一、4月宏观经济.....	2
1、全球制造业走势趋弱，不确定增加.....	2
2、电子信息制造业持续萎缩，陷入低迷.....	3
3、半导体销售大幅下跌，指数回落.....	4
二、4月芯片交期趋势.....	5
1、整体芯片交期趋势.....	5
2、重点芯片供应商交期一览.....	5
三、4月订单及库存情况.....	6
四、4月半导体供应链.....	7
1、半导体上游厂商.....	7
(1) 硅晶圆/设备.....	7
(2) 原厂.....	8
(3) 晶圆代工.....	9
(4) 封装测试.....	9
2、分销商.....	10
3、系统集成.....	10
4、终端应用.....	11
(1) 消费电子.....	11
(2) 新能源汽车.....	12
(3) 工控.....	13
(4) 光伏.....	13
(5) 储能.....	14
(6) 服务器.....	14
(7) 通信.....	15
五、分销与采购机遇及风险.....	15
1、机遇.....	15
(1) 曙光初现，MLCC处于景气度上行拐点前夜.....	15
(2) 市场回转，模拟IC价格下跌趋势减缓.....	15
2、风险.....	15
(1) 不及预期，MCU库存去化进度仍待消化.....	16
(2) 突遭放弃，Intel停止生产比特币挖矿系列芯片.....	16
六、小结.....	16
免责声明.....	17

图表目录

图表 1: 4月全球主要经济体制造业 PMI.....	3
图表 2: 2023Q1 电子信息制造业运行情况.....	3
图表 3: 2023Q1 全球半导体行业销售额及增速.....	4
图表 4: 4月费城及申万半导体指数走势.....	4
图表 5: 4月芯片交期趋势.....	5
图表 6: 2023年4月部分厂商交期及趋势一览.....	5
图表 7: 4月头部企业订单及库存情况.....	6
图表 8: 4月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况.....	7
图表 9: 4月主要原厂最新动态.....	8
图表 10: 4月主要晶圆代工厂最新动态.....	9
图表 11: 4月主要封测厂商动态情况.....	9
图表 12: 4月主要元器件分销商最新动态.....	10
图表 13: 4月主要系统集成商最新动态.....	10
图表 14: 4月消费电子厂商最新动态.....	11
图表 15: 4月新能源汽车厂商最新动态.....	12
图表 16: 4月工控厂商最新动态.....	13
图表 17: 4月光伏厂商最新动态.....	13
图表 18: 4月储能厂商最新动态.....	14
图表 19: 4月服务器厂商最新动态.....	14
图表 20: 4月通信厂商最新动态.....	15



序章

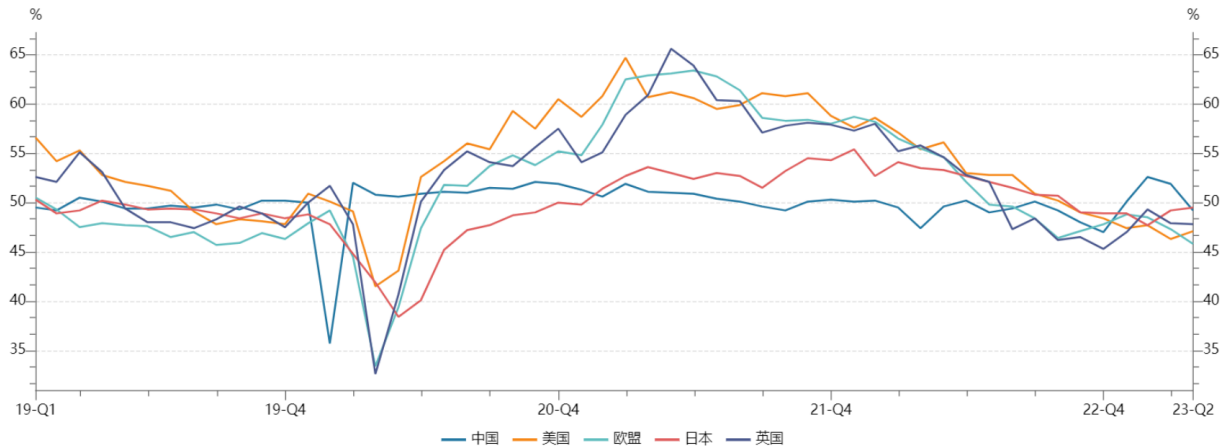


一、4月宏观经济

1、全球制造业走势趋弱，不确定增加

4月，全球经济指数回落，包括中国、美国、欧盟、英国及日本等主要经济体均低于临界点，经济恢复动力仍需巩固。

图表 1: 4月全球主要经济体制造业 PMI



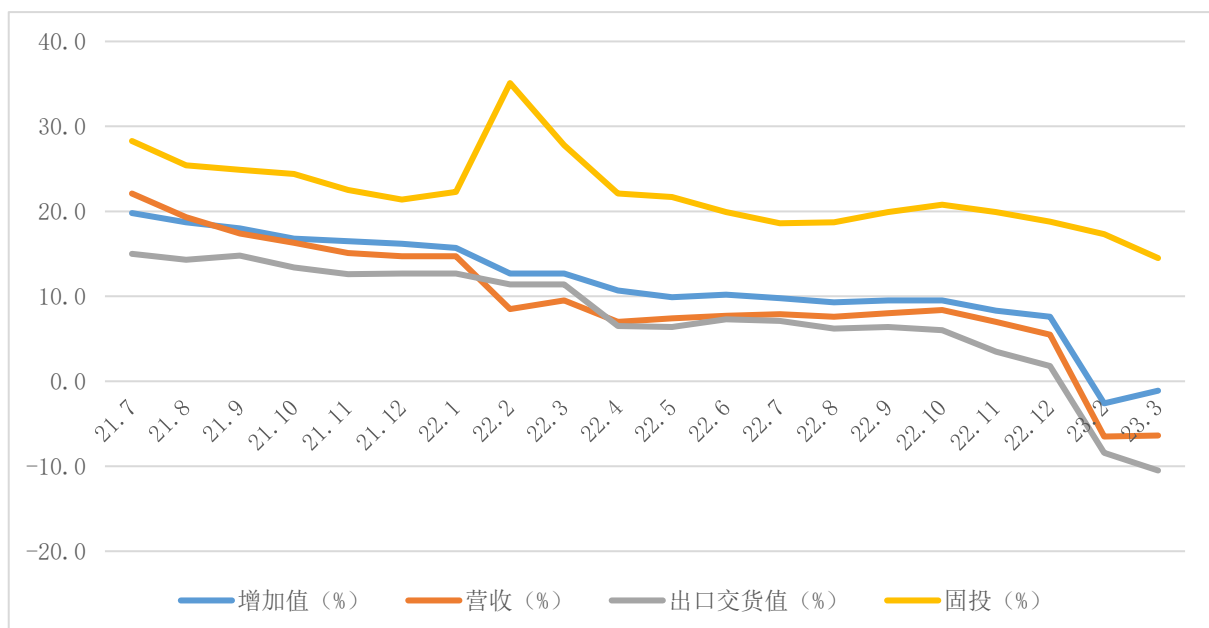
资料来源: 国家统计局

综上, 整体制造业的萎缩速度在加快, 全球经济前景持续不稳。

2、电子信息制造业持续萎缩, 陷入低迷

2023Q1, 电子信息制造业生产降幅收窄, 出口持续下滑, 效益有所改善, 投资保持增长。

图表 2: 2023Q1 电子信息制造业运行情况

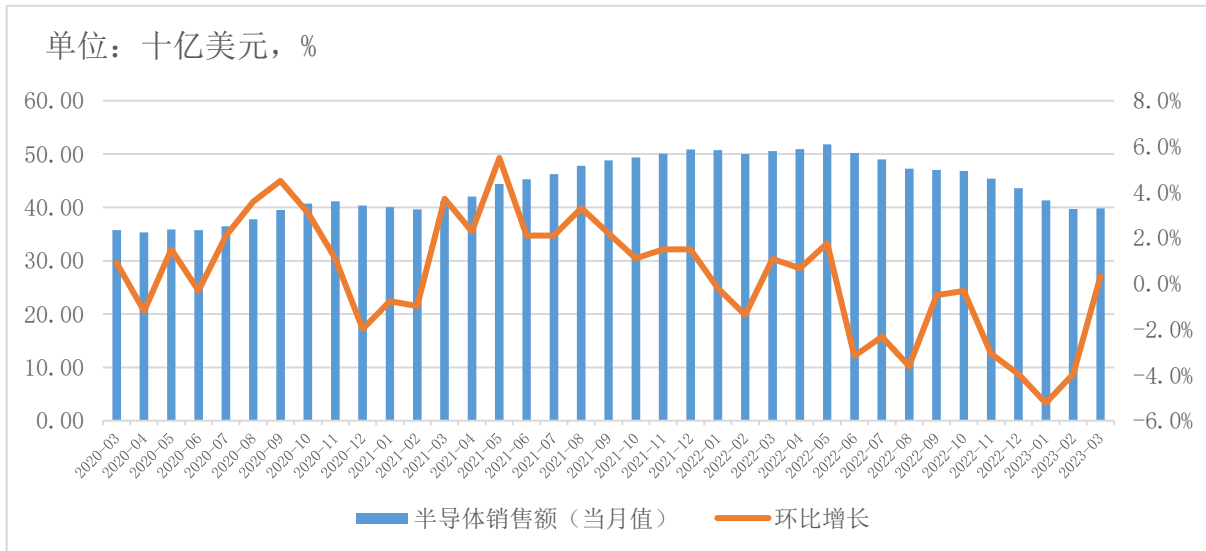


资料来源: 工信部

3、半导体销售大幅下跌，指数回落

2023Q1，全球半导体销售额为 1195 亿美元，环比下降 8.7%，同比下降 21.3%。从区域来看，中国大陆同比跌幅达 34.1%，是表现最差的地区。

图表 3：2023Q1 全球半导体行业销售额及增速



资料来源：SIA、芯八哥整理

从资本市场指数来看，4月费城半导体指数（SOX）下跌 6.4%，中国半导体（SW）行业指数跌幅达 10.0%。受市场需求影响，指数回落。

图表 4：4月费城及申万半导体指数走势



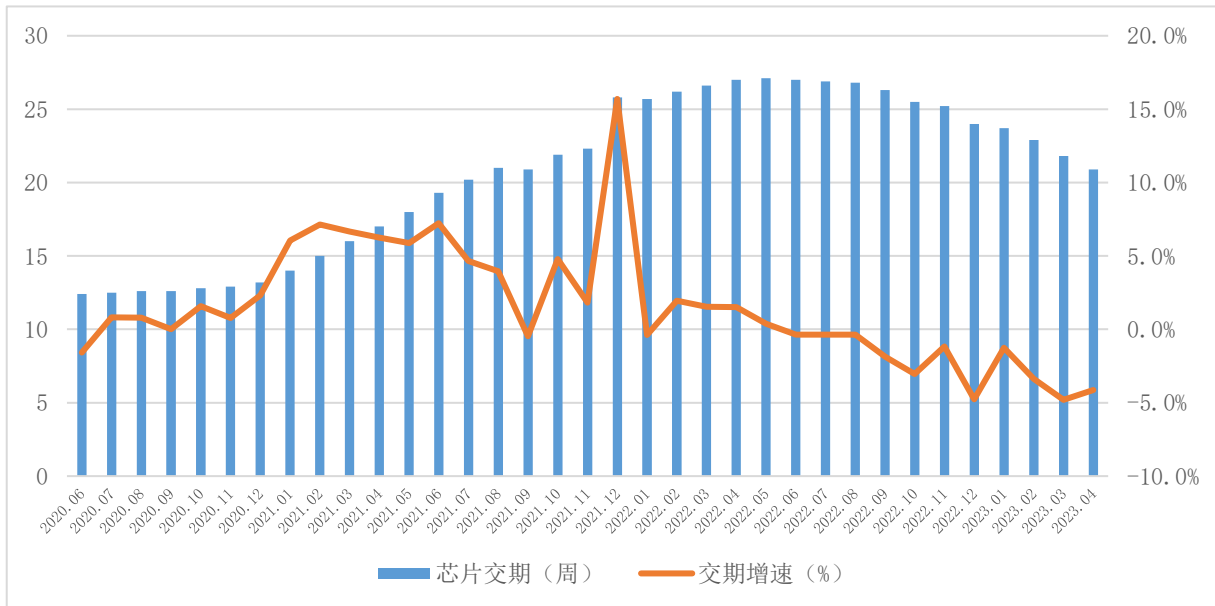
资料来源：Wind

二、4月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

4月，根据最新不完全预测数据显示，全球芯片交货周期低于20周。

图表 5：4月芯片交期趋势



资料来源: Susquehanna Financial Group

2、重点芯片供应商交期一览

从4月最新动态监测看，头部厂商通用料交期已逐渐回归常态，车规料是增长主力。

图表 6：2023年4月部分厂商交期及趋势一览

厂商	类型	4月交期/周	代表料号	趋势
TI	消费料	6-8	/	通用料回归常态，汽车料是增长核心
	工控料	10-12	TMS320F2837x	
	车规料	30-50	TPS 系列	
ST	车规料	40-52	L9680 等	需求主流
	通用料	16-20	STM32FO 系列等	回归常态
NXP	车规料	26-36	l.MX 系列	车规料是增长核心

厂商	类型	4月交期/周	代表料号	趋势
Infineon	车规料	26-52	Aurix TC2XX 系列、TLE 系列等	功率件库存上升明显
On semi	工控料	35-50	MBRS 系列	交期趋稳
瑞萨	MCU	40-50	R5 和 R7 系列	MCU 需求增长明显
ADI	电源 IC	20-35	LTM 系列	个别热门型号仍在高价
	常规料	13-20	/	有降价可能
XILINX	FPGA	20-65	7 系列和 6S 系列	热度较高，有降价趋势
微芯	通用料	正常	MCP17XX、MCP25XX 等	整体交期较长，但逐步恢复
	MCU	36-52+	ATXMEGAx	
	FPGA	40-52	A42MX24-FPQ160 等	

资料来源：富昌电子、Wind、芯八哥整理

三、4月订单及库存情况

从企业订单及实际库存情况看，消费类厂商库存好转，工控料供给和价格趋于稳定，车规料是增长“主力”。

图表 7：4月头部企业订单及库存情况

公司	4月订单情况	4月库存情况	2023Q2 定价趋势
Intel	下降	一般	根据市场调整
AMD	下降	一般	稳定
三星	下降	一般	稳定
TI	下降	低	根据市场调整
ST	稳定	低	根据市场调整
ADI	稳定	低	稳定
高通	下降	一般	根据市场调整
博通	下降	一般	下降
NXP	上升	低	上升
Infineon	上升	低	上升
瑞萨	上升	低	根据市场调整
On Semi	上升	无	上升

公司	4月订单情况	4月库存情况	2023Q2 定价趋势
Microchip	稳定	一般	稳定
镁光	下降	一般	下降
SK 海力士	下降	一般	下降
村田	下降	低	稳定
联发科	下降	一般	下降

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、4月半导体供应链

供给端代工厂产能下调仍未妥协降价，需求端有所回调但不及预期。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

4月，ASML 疑遭砍单，关注日本加码设备限制出口影响；受需求影响，硅晶圆的短期内供大于求。

图表 8：4月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	4月订单	4月库存	2023Q2 订单预测
设备	ASML	下滑	低	根据市场情况调整
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	根据市场情况调整
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	根据市场情况调整
	北方华创	稳定	低	上升
	中微公司	稳定	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco(胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降

类型	企业	4月订单	4月库存	2023Q2 订单预测
	沪硅产业	稳定	一般	下降

资料来源: 芯八哥整理

(2) 原厂

4月, 智能手机为代表的消费市场调整不及预期, 车规级将成为增长“希望”。

图表 9: 4月主要原厂最新动态

厂商	4月动态
Intel	GPU 工艺拟采用 4nm/3nm 制程; Q1 营收创 2010 年以来历史新低
AMD	AI 方向是公司发展核心; Q1 营收同比下降了 9%
英伟达	推迟采用台积电 3nm 计划
TI	Q1 仅汽车业务实现增长
高通	手机市场需求仍在持续下降
三星	Q2 或出现 15 年首次季度亏损; 芯片拟减产 15~25%
联发科	发布 Dimensity Auto 汽车平台; Q1 业绩创近九个季度以来低点
博通	需求持续放缓
ADI	5 月份拟调整旗下产品价格
ST	与采埃孚签署碳化硅器件长期供应协议
Infineon	2023 财年汽车业务产品产能已全部预订
NXP	或加大印度半导体投资
瑞萨	消费类需求下半年将持续下降, 汽车需求存在不确定性
On Semi	和极氪签署碳化硅功率器件长期供应协议
Microchip	整体交期逐步恢复
ARM	或自主开发制造芯片
铠侠	与西数 218 层 3D NAND Flash 出货, 2023 年内量产
Rapidus	2027 年量产 2nm, 还要建 1nm 芯片厂
SK 海力士	扩大无锡 DRAM 厂 21 纳米生产线的产能比重
Marvell	推出全球首款台积电代工的 3nm 数据中心芯片
国巨	下半年库存可能恢复正常水平
华为	Q1 营收 1321 亿人民币, 同比增长 0.8%
兆易创新	消费行业库存去化成果显著
中兴	与联创达成合作发布基于车规级 4G 模组打造的 T-BOX 产品方案

厂商	4月动态
士兰微	预计年底将月产 6000 片 6 英寸 SiC 芯片
紫光展锐	推出了旗下首款车规级 5G 智能座舱芯片平台 A7870
长鑫存储	拟今年进行 IPO，估值千亿人民币
扬杰科技	拟 10 亿元投建 6 英寸碳化硅晶圆项目

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

4月，以台积电为首的代工厂强势控产稳价。

图表 10：4月主要晶圆代工厂最新动态

厂商	4月产能利用率	4月动态	2023Q2 价格趋势
台积电	70%-90%	报价冻涨，提出“加量回馈方案”	下降
三星	<85%	4nm 制程工艺良品率已接近台积电	下降
联电	70%	景气未见强劲复苏，资本支出维持不变	稳定
中芯国际	70%-80%	2022 年全球代工市场份额达 6.01%	降
格芯	<85%	已起诉 IBM 盗用商业机密	稳定
世界先进	50%-65%	部分客户需求增加，但仍有客户进行库存调整	下降
力积电	<60%	今年仍调薪 3%至 5%	下降

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

4月，先进封装需求也陷入疲软。

图表 11：4月主要封测厂商动态情况

厂商	4月产能利用率	4月动态	23Q2 订单预测
日月光	<80%	Q1 营收 1308.91 亿新台币，环比减 26.2%，同比减少 9.35%	下降
长电科技	80%左右	Chiplet 超大尺寸高密度扇出型倒装封装取得重大突破	下降

厂商	4月产能利用率	4月动态	23Q2 订单预测
通富微电	80%-90%	5nm 工艺 Chiplet 产品已逐步量产	下降
华天科技	<80%	Q1 净亏损 1.06 亿元, 由盈转亏	下降
气派科技	80%-90%	Q1 营收 9592.74 万元, 同比减少 24.12%	下降
中小封测厂	40%-60%	大规模衰退走势	下降

资料来源: 芯八哥整理

2、分销商

4月, 分销商积极布局新能源汽车。

图表 12: 4月主要元器件分销商最新动态

厂商	4月动态
安富利	高压快充是未来方向, 碳化硅大规模上车为时尚早
大联大	看好中国新能源汽车市场机会
贸泽电子	Q1 推出逾 15000 个新物料
富昌电子	发布专注于工业自动化垂直领域全球计划
中电港	深交所挂牌上市
雅创电子	未来将专注于汽车电源管理 IC
好上好	联发科是公司的主要供应商之一
英唐智控	拟与新思 DDIC 产品展开合作
力源信息	公司实现营业收入 11.85 亿元, 同比下滑 49.98%

资料来源: 芯八哥整理

3、系统集成

4月, 工控需求持平; 汽车需求不确定性增加; 消费电子需求复苏不及预期。

图表 13: 4月主要系统集成商最新动态

类别	厂商	4月动态
工控	ABB	完成对西门子低压 NEMA 电机业务收购
	西门子	与 FREYR 在规模化、可持续电池生产方面达成战略合作
	施耐德电气	开关面板类部分产品价格于 5 月 1 日起上调 6%-17%

类别	厂商	4月动态
	罗克韦尔	2023Q2 财年净利润为 2.88 亿美元，同比增长 133.65%
	汇川技术	在探索 AI 技术在工业现场的应用落地
汽车	现代摩比斯	公司今年在中国的收入目标为 10 亿美元
	麦格纳国际	奥迪一汽新能源汽车配套项目麦格纳智能制造项目开工
	博世集团	与台积电合作在德国建厂
	华为	高阶智能驾驶系统 ADS 2.0 发布
	法雷奥	受益于 ADAS 业务增长，Q1 营收 55 亿欧元，同比增长 15%
	采埃孚	与美国芯片制造商 Wolfspeed 将在德国设立碳化硅研发中心
	博格华纳	与法国电力在新能源领域订战略合作协议
消费电子	闻泰科技	手机 ODM 业务盈利能力下滑，汽车、工业是增长动力
	华勤技术	2022 年智能手机 ODM 出货量市占率高达 28%，与龙旗并列第一
	立讯精密	智能手机除高端产品外，其他需求需求缩小
	歌尔股份	Q1 净利降 88%，声学整机遭大客户砍单
	鸿海	收购 4 座日月光工厂，攻车用第三代半导体封装；获微软伺服器代工订单
	和硕	将成苹果 iPhone15 Pro 系列供应商
	广达	投资 1.2 亿美元在越南建厂

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

4 月，消费电子市场需求仍然低迷，业内评估消费电子复苏或到 2023Q4。

图表 14：4 月消费电子厂商最新动态

类别	企业	4月动态
智能手机	苹果	Q1 实现收入 739.29 亿美元，其中 iPhone 收入为 513 亿美元
	三星	Q1 智能手机出货量为 6060 万部
	华为	Q1 位居全球智能手机出货量前十 (2%)
	小米	Q1 在印度智能手机出货暴跌 41%
	OPPO	Q1 智能手机出货量为 3050 万部
	Vivo	旗下独立子品牌 IQOO 将与公司进一步整合
PC	联想	PC 行业下半年有望重回增长

类别	企业	4月动态
	惠普	Q1 出货量下滑 24.2%
	华硕	Q1 出货量下滑 29.3%
	戴尔	Q1 出货量下滑 31.0%
VR/AR	Meta	在 Reels、Stories 应用中引入 AR 广告业务
	歌尔	新增虚拟现实设备制造业务
	苹果	获得 25 个涵盖 XR/AR/MR/AR/VR 开发流程专利

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

受终端需求不及预期影响,车用芯片设计厂商 Q2 或加大砍单力度,环比降幅约 10~20%,涉及主要品类包括电源管理 IC、驱动 IC、MOSFET、IGBT 等

图表 15: 4月新能源汽车厂商最新动态

厂商	4月动态
比亚迪	考虑在西班牙修建新超级工厂
特斯拉	Q1 交付量 42.29 万,创下历史新高
现代	联合 SK On 与 LG 新能源在美国建电池工厂
大众	将投资 10 亿欧元在合肥建电动汽车研发及采购中心
宝马	Q1 电动汽车交付量约 64647 辆,同比增长 83%
奔驰	至 2023 年底在华新能源产品矩阵将达 17 款
丰田	将在巴西投资 3.38 亿美元,生产新型混合动力车
广汽埃安	4 月销量 4.1 万辆,同比增长 301.61%
吉利	计划到 2025 年新能源销售占比达 50%以上
奇瑞	旗下车型首发搭载宁德时代钠离子电池
蔚来	与恩智浦开展 4D 成像雷达合作
小鹏	发布 SEPA 2.0 扶摇架构,全域 800V 高压 SiC 碳化硅平台
理想	2 亿元成立江苏常想动力推进芯片自研
腾势	4 月销售 10526 辆,成交均价破 42 万元
上汽	4 月新能源汽车销量 6.8 万辆,同比增长 80.59%

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

4月，工控行业需求呈现偏弱运行态势。

图表 16: 4月工控厂商最新动态

厂商	4月动态
施耐德	加尔各答新工厂奠基
三菱电机	将剥离其汽车设备业务
西门子	到2025年“数字工业”（工业软件和工厂自动化等）在华营收比2020年翻番
信捷电气	Q1营收3.29亿元，同比增长2.31%
英威腾	Q1工业自动化业务营收5.5亿元，同比增长29%
禾川科技	Q1营收2.76亿元，同比增长44.38%
埃斯顿	AI技术的应用是机器人未来发展方向之一
汇川技术	公司机器人在3C、光伏、锂电等行业已实现大批量销售
新时达	Q1营收9.11亿元，同比增长11.43%
麦格米特	在充电桩领域已具备整机生产能力

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

4月，关注美国取消东南亚光伏关税豁免决议对国内光伏产业链影响。

图表 17: 4月光伏厂商最新动态

厂商	4月动态
阳光电源	下半年将释放更多项目，订单情况不错
天合光能	光伏组件出货快速增长
锦浪科技	光伏行业充分竞争，看好储能行业长期发展
固德威	与英飞凌携手加强供应链安全
英威腾	近期正在启动华南产业基地项目
德业股份	Q1逆变器营收14.53亿元，同比增长331.49%，占总营收70%
古瑞瓦特	加速海外市场扩张

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

储能有望成为光伏及其他领域厂商转型的潜力细分市场之一。

图表 18: 4月储能厂商最新动态

厂商	4月动态
阳光电源	2022年公司储能系统营收101.26亿元，同比大增222.74%
科士达	储能业务主要以ODM+自有品牌在海外发展
上能电气	2022年储能双向变流器及系统集成产品营收10.2亿元，同比增幅达6倍
科陆电子	公司目前有宜春、成都两个储能生产基地
德业股份	2023年预计公司储能逆变器出货80万台（70万台户用+10万台工商业）
英威腾	2023年会在储能产品（户用、工商业等）等方面发力
固德威	2022年公司在中国企业全球储能小功率PCS（30kW以下）出货量排名第一
天合光能	2022年公司储能国内出货量超过1.5GWh
鹏辉能源	拟再投73亿扩产储能电池
特斯拉	将在上海新建储能超级工厂

资料来源：芯八哥整理

(6) 服务器

4月，短期内行业需求呈现一定下行态势。

图表 19: 4月服务器厂商最新动态

企业	4月动态
宁畅	正式成为开放计算标准工作委员会成员单位
浪潮	服务器价格目前较稳定
中兴通讯	计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器
戴尔	联合AT&T推出5G驱动型边缘计算产品
HPE	Q1服务器出货季减达双位数

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

5G 建设放缓成为当前设备商面临的主要挑战。

图表 20：4 月通信厂商最新动态

企业	4 月动态
烽火通信	东南亚、拉美等海外目标市场仍具备增长潜力
中兴通讯	2022 年 5G 基站、5G 核心网、光传输 200G 端口发货量均为全球排名第二
诺基亚	计划在芬兰最多裁员超 200 人
爱立信	通信行业全年需求将面临波动
Infinera	经济衰退抑制了运营商的需求

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

(1) 曙光初现，MLCC 处于景气度上行拐点前夜

据业内供应链透露，MLCC 供给端降价去库存周期（2021Q3-2023Q1）已持续了一年半左右，2022Q4 末行业已经基本见底，当前行业处于景气度上行拐点前夜，供给端正逐步恢复健康，随着下游需求端逐步回暖，重点关注村田、太阳诱电及国巨、三环、风华高科等相关企业。

(2) 市场回转，模拟 IC 价格下跌趋势减缓

近期，受益于 TV、PC 等部分消费电子订单需求回补，业内预估 Q2 模拟 IC 市场将有明显起色，甚至也有厂商早已开始重新投片。尽管仍有部分通用型产品降价中，但多数已经出现止跌信号。关注 TI、ST、ADI 等头部厂商最新动态。

2、风险

(1) 不及预期，MCU 库存去化进度仍待消化

据悉，就当前 MCU 库存水位来看，库存去化到 Q3 基调已经确定，主要是在多地经济逐渐恢复后，整体市场订单需求有所回补，但拉货力道确实不如先前预期。具体企业方面，重点关注 NXP、ST、TI 及 Infineon 产品交期及价格变化。

(2) 突遭放弃，Intel 停止生产比特币挖矿系列芯片

2022 年 3 月，Intel 曾正式宣布该公司进入加密矿业，称英特尔芯片的性能将比基于 SHA-256 算法而进行挖矿的主流 GPU 高出 1000 多倍。近期，在比特币价格回升之际，半导体巨头 Intel 正式宣布其比特币挖矿系列芯片的生命周期结束，也没有公布任何后续芯片。谨慎评估该领域代表厂商英伟达及比特大陆、比特微等。

六、小结

当前，处于景气度上行拐点前夜，供给端代工厂产能下调仍未妥协降价，需求端有所回调但不及预期。

免责声明

本文由芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

深圳华强电子网集团股份有限公司

2023年05月

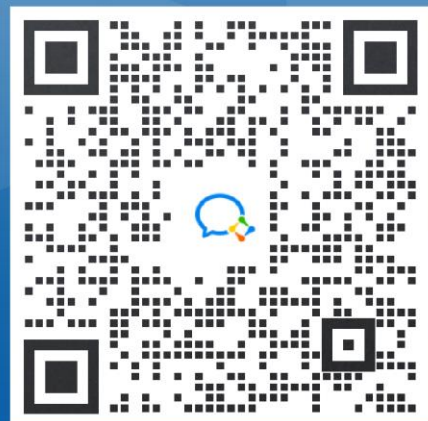


<<< 扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、
厂商动态和行业趋势报告

加入芯八哥半导体行业交流群 >>>

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、
行业白皮书免费领取





更高效 更透明 重构产业生态

仓储服务 元器件采购 信息服务 API/FTP
PCB制板 BOM工具 SAAS

www.hqewgroup.com

深圳总部

电话：86-755-83396000

传真：86-755-26421633

地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦
B座4、7、9、12楼